

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2025-036

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于公司对外投资进展暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、投资事项基本背景

苏州晶方科技半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶方科技”）专注于传感器领域先进封装技术服务，通过技术自主创新、积极融入全球产业链体系、开展先进技术国际并购整合等，发展为全球传感器领域晶圆级 TSV 封装技术的领先者，核心客户涵盖国际头部设计公司，在全球传感器细分产业链中占据一席之地。

近年来，全球政治格局形势剧变，国际间战略博弈日趋激烈。集成电路产业作为信息经济时代的战略性基础产业，尤其成为大国博弈竞争的战略焦点，全球产业链正在发生重构整合，呈现区域性、本地化发展趋势。为有效应对产业重构趋势，稳固公司市场地位，拓展公司产业服务能力，公司 2022 年开始积极推进国际化发展战略，进行市场、供应链、生产制造能力的全球布局。2023 年 5 月在新加坡 100%持股设立海外总部平台 Optiz Technology Pte. Ltd.、Optiz Pioneer Holding Pte. Ltd.（简称“OPTIZ”），将公司海外投资项目的股权架构调整到 OPTIZ 名下，并开始筹划海外生产基地的建设；2024 年 6 月，通过 OPTIZ 在马来西亚 100%持股成立 WaferTek Solutions Sdn. Bhd.（以下简称“WaferTek”），由 WaferTek 作为公司海外业务拓展与生产制造主体，积极推进海外生产基地布局，并筹划牵头参股设立 WaferWise Semiconductor Sdn. Bhd. 公司（以下简称“WaferWise，具体名称以注册核准为准），由其根据海外市场与客户需求实际情况，向客户提供相关产品的封装技术与加工服务，协同 WaferTek 更好应对未来的不确定性挑战风险。

## 二、对外投资进展及规划

WaferTek 成立以来，积极筹划海外生产基地拓展布局，努力推进土地厂房购买洽谈、生产工艺与产线规划、供应链拓展、团队组建等相关工作。截至目前土地厂房购买相关的协议签署、资产交割均已完成，并开始进入厂务系统、无尘室装修的施工阶段。生产工艺与设备选型、团队组建与培训工作正在有序展开。WAFERWISE 的设立工作也正在积极筹划推进。鉴于设备购置内容及购置价款的变化情况，为有效推进 WAFERWISE 的项目建设，更好应对未来不确定性挑战风险，拟将 WAFERWISE 规划的投资额进行优化调整，调整后的基本情况如下：

### （一）设立基本情况

公司名称：WaferWise Semiconductor Sdn. Bhd.

注册地址：马来西亚槟城

投资规模：1.5 亿元林吉特

股权架构：马来西亚产业、政府背景投资人合计持股 50%、WaferWise 核心团队 8%、晶方科技持股 19.9%、公司董事长兼总经理王蔚持股 22.1%

出资方式：各方均以现金出资

经营范围：集成电路产品制造与加工、相关技术服务、研究和开发、产品进出口、技术咨询服务等商业、技术研发等

## 三、关联交易情况

### 1、关联方关系介绍

王蔚先生为公司董事长、总经理，本次公司与其共同投资设立 WaferWise，该事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 2、关联人基本情况

王蔚：男，中国国籍，身份证号：320504196602\*\*\*\*\*，有丰富的通信、电子、PCB、集成电路等领域的工作经验。1999-2004 年任职于 Camtek Ltd.，担任大中国区总经理。2005 年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现

任公司董事长、 总经理， 苏州市集成电路行业协会理事长。

#### 四、对外投资对上市公司的影响及风险提示

公司以 WaferTek 作为核心主体，进行海外市场拓展与海外生产基地建设、以及牵头参股投资设立 WaferWise，旨在提升公司生产制造与技术服务能力，更好贴近海外市场与客户需求，有效推进公司国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局，从而有效应对国际贸易博弈、全球产业链重构的发展趋势。

马来西亚拥有良好的商业环境，槟城是马来西亚最重要的制造业中心之一，在电子、半导体、汽车零部件等领域具备良好的产业与人才基础。受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等诸多因素影响，本次投资预期的实现也相应存在不确定性的风险。公司将努力推进全球业务、生产制造能力建设、项目拓展等事项的动态布局，整合各项资源，做好相关风险的管理工作，切实有效地降低投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日